

Challenge 30

誇りあるTOWAブランド確立に向けて!

中期経営計画説明会

2006年4月

TOWA株式会社

本日の説明内容

1. 2006年3月期業績予想修正
2. 中期経営計画

1. 2006年3月期業績予想修正

2006年3月期業績予想(連結) (百万円)

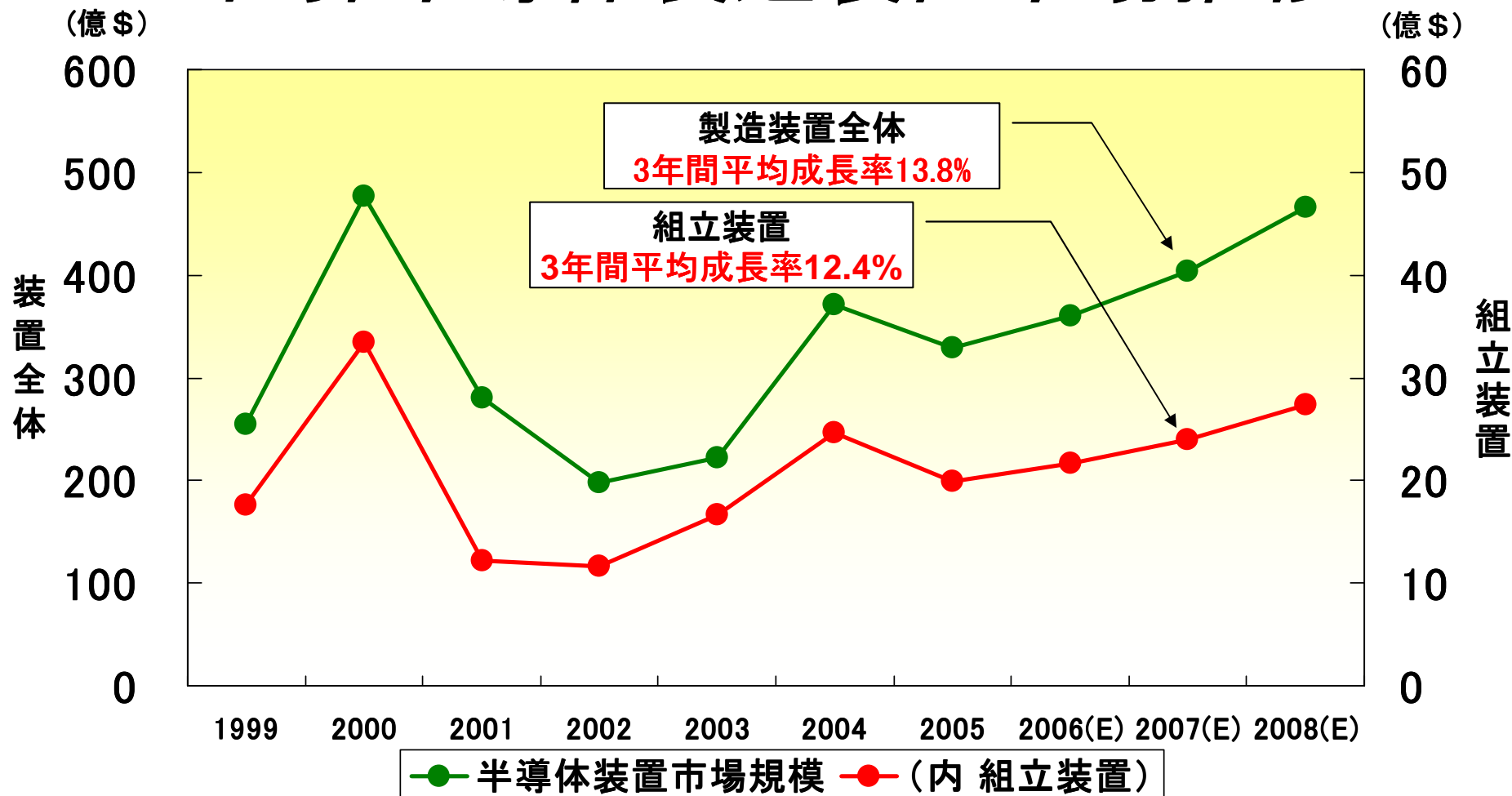
	11月9日発表		今回修正		増減額 (増減率)
	金額	構成比	金額	構成比	
売上高	18,900	100.0%	19,000	100.0%	100 (0.5%)
経常利益	-1,100	-5.8%	-2,700	14.2%	-1,600 (—)
当期純利益	-4,300	-22.8%	-5,900	31.1%	-1,600 (—)

業績予想の修正理由

- TOWA-Interconの業績不振
- 金型売上高構成比率の低下
- 原材料・仕掛品・展示機および貸出機の評価損
- ウエハ洗浄装置、ボンダー関連装置事業からの撤退に伴う処分損
- 海外生産子会社の縮小整理、早期退職優遇制度の導入に関する引当金等
- 役員退職慰労引当金の取り崩し

2. 中期経営計画

世界半導體製造裝置市場推移



中期経営指針

当社のコア・コンピタンスたる「金型関連技術」、「モノづくり」への原点回帰により収益体質を確立し、「PMシリーズ」をはじめ新製品を世界市場へ投入することによって新たなる成長路線を構築する。

1. 事業ポートフォリオの見直し

- ① モールディング分野とシンギュレーション分野に特化
- ② LED市場をはじめとして成長分野へコア・コンピタンスを展開
- ③ 新素材等の開発による新事業領域への開拓

2. 販売戦略の強化

① 新製品「PMシリーズ」によるシェア拡大と製品差別化競争への転換



PMシリーズ

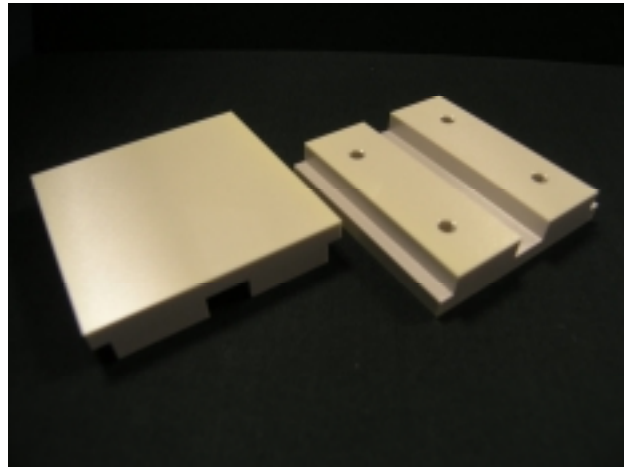
ダブルレイヤー方式採用

- ・ 型締力 1/2
- ・ 設置面積 Yシリーズ比 $\Delta 30\%$
- ・ 樹脂使用量 従来比 $\Delta 20\sim 30\%$

COOの大幅削減に貢献！

- ・ グリーンコンパウンド対応／高離型金型

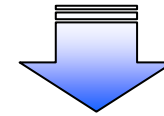
金型材向けにセラミックス新素材を開発



セラミックス新素材

(課題)

グリーンコンパウンドの採用により、樹脂と金型との粘着性が高まり、クリーニング頻度が増え生産性が低下



高離型性(離型抵抗値 従来比10分の1)を持つセラミックス新素材を開発

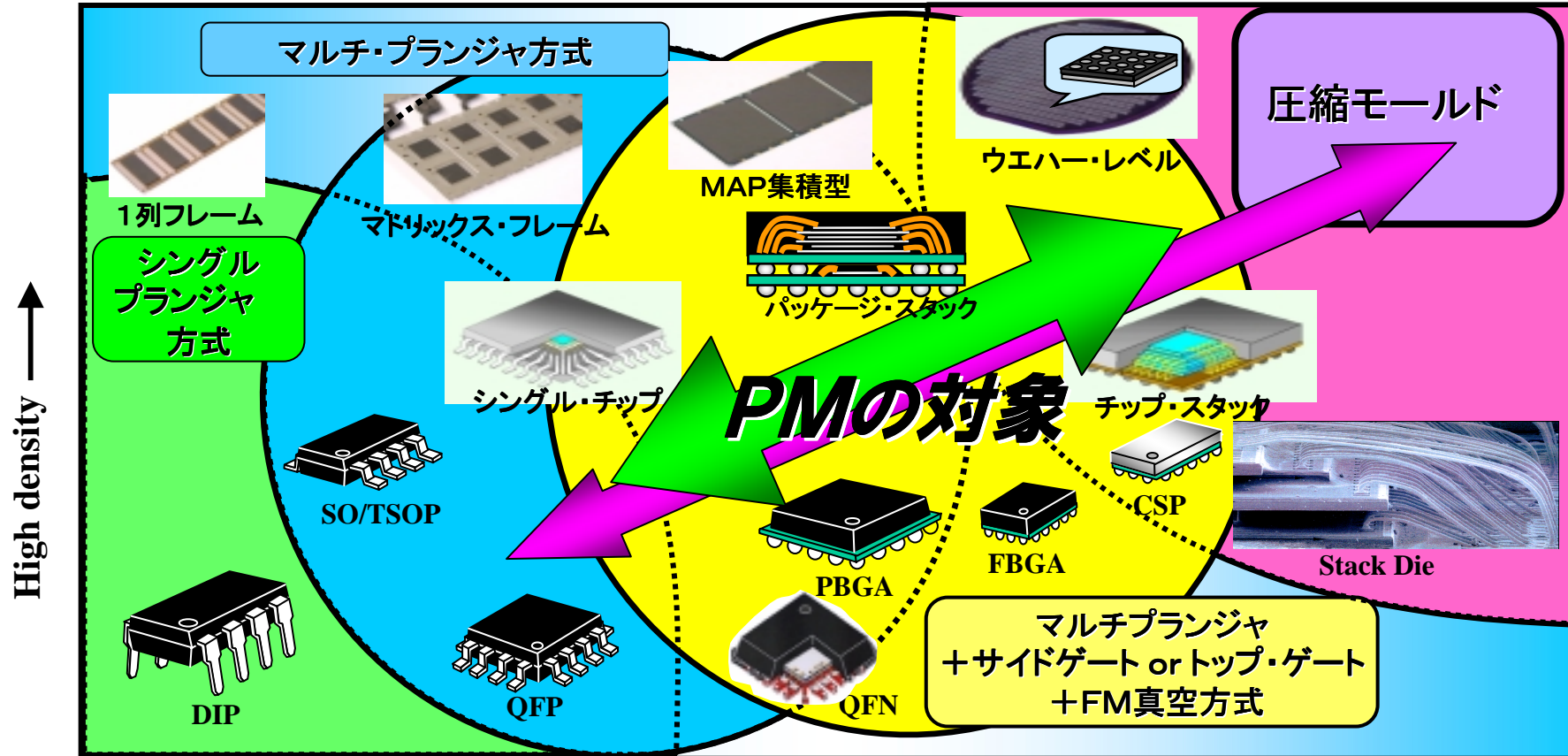
- ・クリーニング工程の削減
- ・製品突出し機構が不用となり、金型構造が簡素化

「PMシリーズ」に搭載

②世界主要IDM上位10位と台湾系を中心としたサブコンの囲い込み強化

- SIP (System In Package)、多段スタック、Low-Kなど最先端パッケージ対応技術の提供
- 台湾系サブコンの中国進出サポート
- 「PMシリーズ」の販売

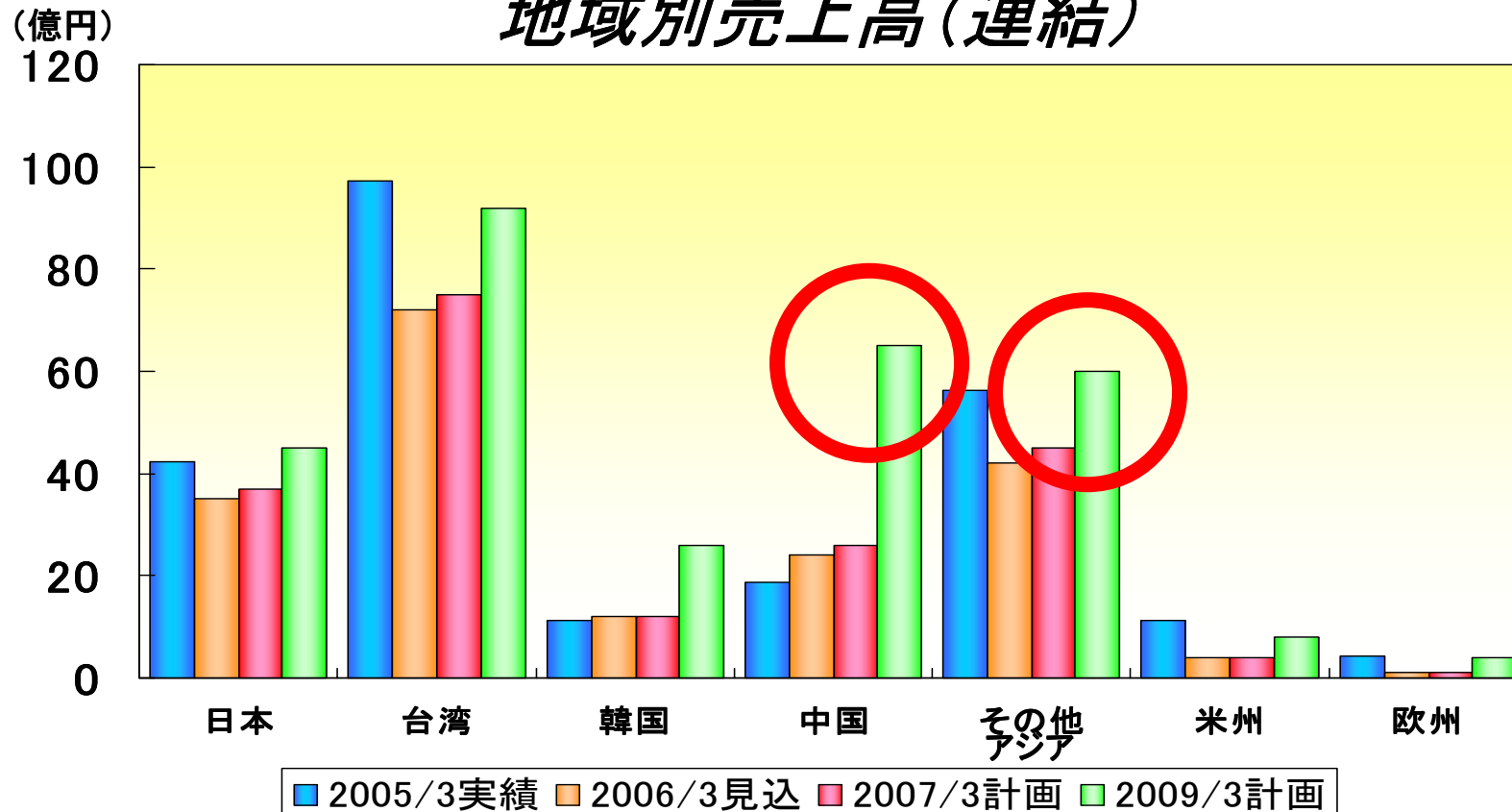
パッケージロードマップと当社のソリューション



Year	1995			2005			2015		
モールド厚 (mm)	3	1	0.5	0.4	0.3	0.2	0.15	0.1	...
モールド幅 (mm)	30		50	75		100	120	150	...
チップ積層枚数	1			2	5	7	...		
ワイヤー長さ (mm)	4		5	6		8	10	...	
ワイヤー径 (μm)	25			20	18	15	12	10	...

③台湾市場に加え、中国市場と東南アジア市場を重点地域に設定

地域別売上高(連結)



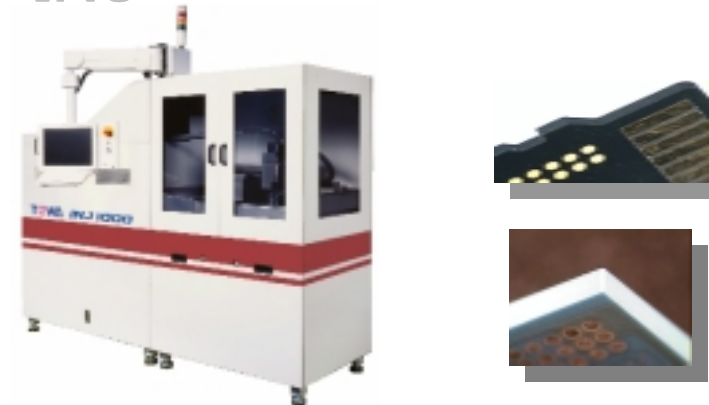
④シンギュレーション装置分野のシェア奪還

SBS



・ダイサー・ハンドラーの一体構造による省スペース化と高スループットを実現

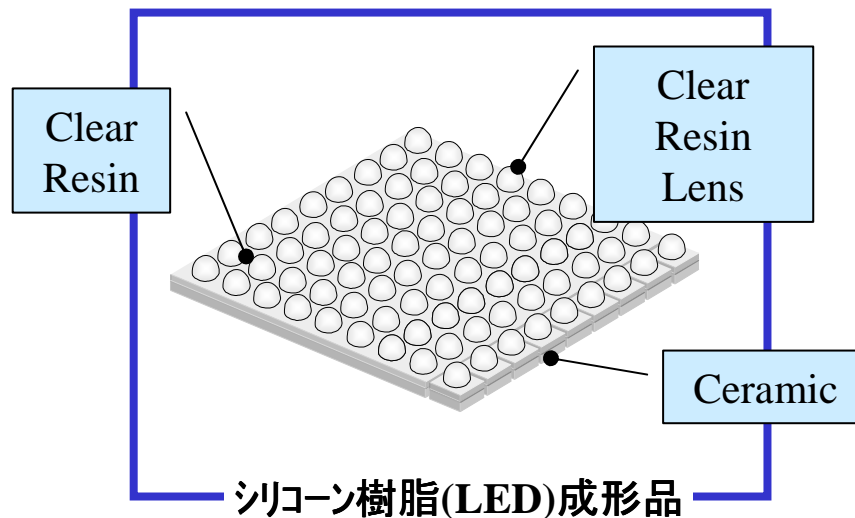
INJ



・これまでのブレードによる切断では不可能だった曲線カットが可能
・複合材料やセラミックなど難削材料の切断にも対応

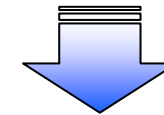
⑤LED市場への製品投入

FFT



(課題)

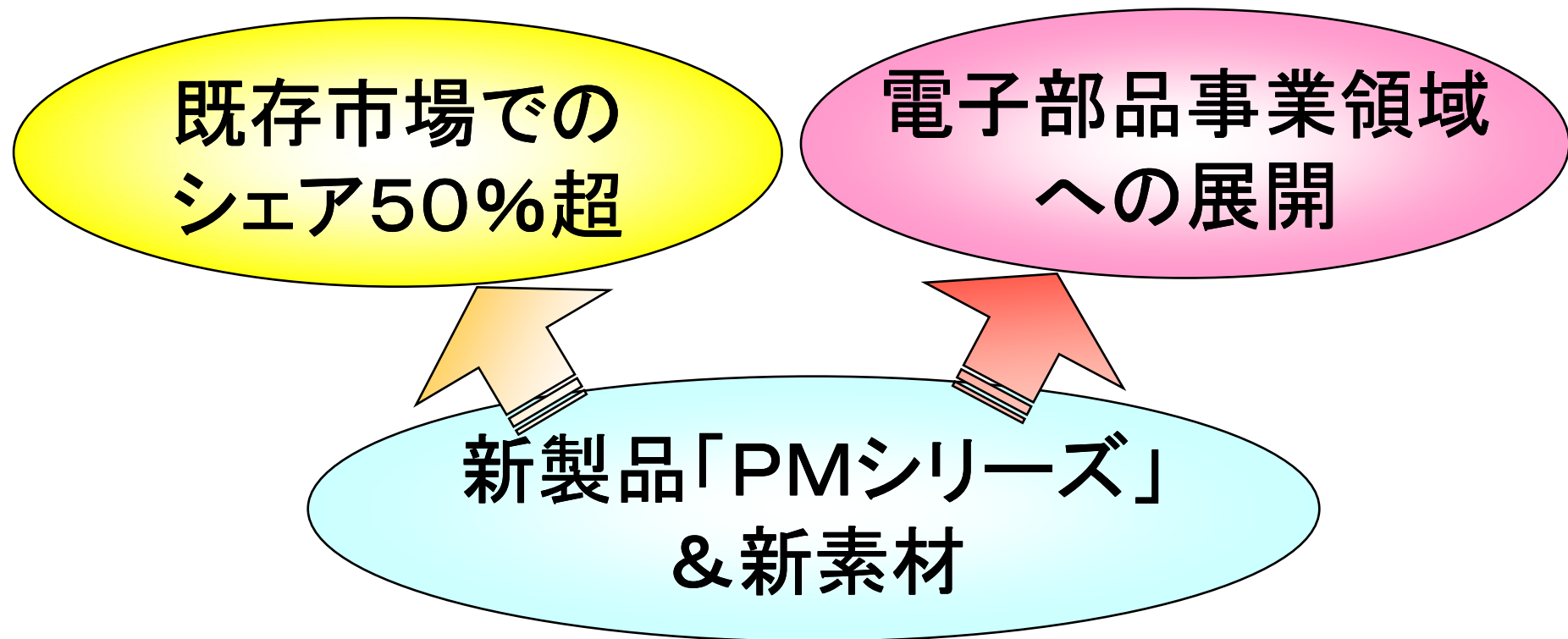
高輝度LEDは紫外線対策のため単価の高いシリコン系樹脂を採用する必要がある。



コンプレッションモールド方式を採用

- ・樹脂効率 ほぼ100%
- ・レンズ形状の成形が安定化
- ・大量生産に対応

⑥新素材を既存装置および電子部品全般の 事業領域にも展開



3. QCDの最適化

- ①既存製品のVE(Value Engineering)
- ②海外生産子会社の稼働率向上
- ③海外生産子会社を含めた生産体制の最適化による物流コスト低減とリードタイム短縮
- ④海外資材調達率の引上げ等による資材購入コストの低減

4. 財務体質の改善

① 第三者割当増資による株主資本の充実

(発行新株式数) 1,000,000株

(発行価額の総額) 8億円

(割当先) 坂東和彦

(目的) 経営者としての責任を表明

株主資本の充実と財務体質の改善

(資金使途) 新素材等の研究開発費 5億円

業務合理化のIT投資 3億円

- ②海外生産子会社の不動産売却による借入金返済
- ③プラットフォーム型先行生産方式の見直しによるたな卸資産の圧縮
- ④売掛金回収期間の短縮

5. 固定費の削減

- ①グループ全体人員20%削減(1,000名体制)
- ②早期退職優遇制度の導入と転籍出向による人員削減(単体400名体制)
- ③TOWA Singaporeの閉鎖と工場売却
- ④TOWA-Interconの大幅なリストラ

固定費総額20億円削減

6. 経営責任の明確化

- 役員退職慰労引当金の全額取り崩しおよび同制度の廃止
- 会長兼社長の役員報酬全額返上および全役員について10～20%カット
- 管理職の給与カット

7. 企業文化・企業組織の改革

- ①CS(Customer Satisfaction)の徹底的
追求
- ②ES(Employee Satisfaction)の高揚
- ③組織の簡素化・フラット化
- ④IT導入による省力化、間接人員の削減

経営目標

